

Cadence Design Systems, Inc.

次世代システムに向けた設計手法の変革

世界の様々なクリエイティブな企業は、未来に向けたテクノロジーの開発を加速するために、厳しい設計要件に対応できる革新的な設計ソリューションを必要としています。ケイデンスは、業界における演算ソフトウェア (Computational Software) のリーダーであり、自社の専門知識をベースに、ソフトウェア、ハードウェア、IPを開発、提供しています。ケイデンスのソリューションは、ハイパースケールコンピューティング、5Gコミュニケーション、自動車、モバイル、航空宇宙、コンシューマー、産業、ライフサイエンスなど、様々な新規市場に向けたアプリケーションの開発において、設計コンセプトを実現するために使用されています。ケイデンスは、Intelligent System Design™の実現に向けたcomputational softwareを開発しています。

電子設計

ケイデンスは、今日の電子設計者が未来に向けた製品を創造するために最善の仕事ができるよう、最も広範かつ統合されたエンドツーエンドのソリューションを提供しています。

- ▶ アナログおよびデジタル回路のシリコンデザイン生成、シミュレーション、インプリメンテーションおよびサインオフ検証ツール、即座に使用可能な設計IP、ICパッケージングツール
- ▶ ICチップからスマートフォン、航空機などのシステムに至るまでサポートするシステム設計およびマルチフィジックス解析ツール、PCB設計ツール、安全でセキュアな組み込みソフトウェア
- ▶ エッジデバイスにおける推論処理デザインに向けたインテリジェンスIP、マシンラーニングを活用したEDAツールや設計フロー

会社概要

設立	1988
本社	2655 Seely Ave. San Jose, CA 95134 USA
Nasdaq銘柄コード	CDNS
事業内容	電子設計およびシステム解析のためのcomputational software開発・販売

提供製品

アナログ・デジタルIC設計ツール

カスタム、アナログ、RF、ミックスシグナル設計支援ツールのリーダーとして、弊社は、設計コンセプトの迅速かつ正確な入力を可能にするツールおよび方法論に始まり、シリコン製造前の設計の検証に至るまで、完全なソリューションを提供しています。カスタムICの設計を選択的に自動化することで、エンジニアは設計の精密化と回路性能の最適化に集中することができます。

チップのデジタル部分の設計については、ここ数年、生産性の向上と設計プロセスの短縮を実現する全く新しい次世代ツールを提供してきました。この包括的な製品群は、フロントエンド設計から最終的なサインオフ検証、設計収束に至るまで、設計サイクル全体を高速化します。

また、ケイデンスのIPポートフォリオには、あらかじめ設計されたコンフィギュラブルなブロックが含まれており、これらをチップ設計に迅速に統合することで、設計チームはこれらの部分を再設計する必要がなくなります。本ポートフォリオには、AI、ビジョン、オーディオ、IoT、ベースバンドアプリケーションに向けたTensilica® DSP、Denali®メモリおよびストレージIP、PCIExpress® (PCIe®)、USB、Ethernetなど最新の標準インターフェース用のコントローラIPが含まれています。

システム検証ツール

Cadence Verification Suiteは、システム企業や半導体企業が他社を差別化する完成品をより効率的に生み出すことを可能にするケイデンスのIntelligent System Design戦略をサポートする要素技術です。Verification Suiteは、クラス最高のコア・エンジン、検証ファブリック・テクノロジー、設計品質と検証スループットを向上させるソリューションで構成されており、様々なアプリケーションや垂直マーケットセグメントの検証要件を満たします。ソフトウェアツールベースのソリューションとハードウェアアクセラレータを組み合わせたユニークなソリューションによって、最短の検証ターンアラウンドタイムと予測可能な品質を実現します。ケイデンスのテクノロジーは、システムレベルのパワーインテグリティとシグナルインテグリティを実現する唯一の実証済みパスを提供します。また、各種インターフェースやメモリの規格を検証するための検証用IP (VIP) も提供しています。

ICパッケージ／PCB設計ツール

これまで提供してきた実績のある3D-ICソリューションに加え、先進的な3D-ICソリューションにも対応した最先端のICパッケージングとPCB設計ソリューションを提供します。ケイデンスのICパッケージングとクロスドメイン協調設計の自動化は、システムレベルの協調設計や高度なミックスシグナルICチップのパッケージングにおける効率的なソリューションを提供し、設計プロセスを促進するための自動化と精度を実現します。PCB設計ソリューションは、コンポーネント設計とシステムレベルのシミュレーションを統合することで、より短く、より予測可能な設計サイクルを可能にし、初回設計を正しく行うためのコンストレイントドリブンな設計フローを実現します。

マルチフィジックス解析／CFDツール

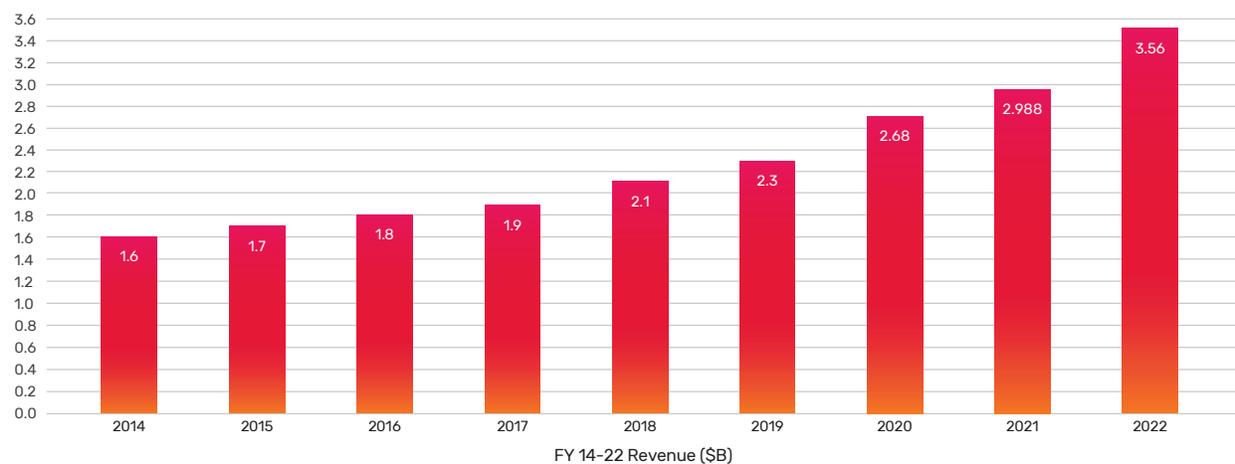
ケイデンスは、EMI (電磁干渉)、EMC (電磁環境両立性)、電気熱、CFD (数値流体力学) に関する各ツールを提供していますが、これらのツールには、メッシングとソルバーと呼ばれる計算負荷の高い2つのステップがあります。メッシングは、固体表面と流体体積の両方を、物理的に解くことのできる小さなピースに分割します。ソルバーは、流体力学の基本方程式を各メッシュに適用して、流体がシステムに与えるマクロな効果を把握します。複雑なシステムの最適設計を選択するためには、設計プロセスにおいて実世界の製品性能を予測することが最も重要です。

働きがいのある会社

ケイデンスは、人材や製品、自社の利益を有効活用し、社会的に責任のある企業であることを目指しています。私たちは、市場や業界をリードするイノベーション、そしてビジネスの成功を実現するための企業文化「One Cadence—One Team」を誇りに思っています。ケイデンスは、Fortune 誌の「働きがいのある会社ベスト100」に過去9年間にわたって選出されるなど、世界中で「働きがいのある会社」として認められています。また、環境、社会、ガバナンス戦略への取り組みも世界的に評価されています。



売上



エグゼクティブ・マネージメント



Anirudh Devgan, PhD
President and
Chief Executive Officer



Karna Nisewaner
Corporate Vice President,
General Counsel, and Secretary



Tom Beckley
Senior Vice President
and General Manager,
Custom IC & PCB Group



Boyd Phelps
Senior Vice President
and General Manager,
Silicon Solutions Group



Paul Cunningham, PhD
Senior Vice President
and General Manager,
System Verification Group



Chin-Chi Teng, PhD
Senior Vice President
and General Manager,
Digital & Signoff Group



Tina Jones
Senior Vice President,
Global Human Resources



John Wall
Senior Vice President and
Chief Financial Officer



Nimish Modi
Senior Vice President
and General Manager,
Strategy and New Ventures



Neil Zaman
Senior Vice President,
Worldwide Field Operations

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 会社概要

会社名	日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 Cadence Design Systems, Japan
商号	ケイデンス・デザイン・システムズ (ジャパン) ビー・ヴィ
所在地	〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 TEL: 045-475-2221 (代) FAX: 045-475-2451 URL: https://www.cadence.com/jp
社長	金子 敏文 (Toshifumi Kaneko)
設立	1997年3月 (1989年4月日本での業務開始)
資本金	3,745,955ユーロ
従業員数	220名
事業内容	米国ケイデンス社の電子設計ツールの開発、 販売、およびサポートと設計支援サービス
販売代理店	イノテック株式会社

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社は、Great Place to Work®より「働きがいのある会社」ベスト100に選出されています。



For More Information

Investor Relations: +1.408.944.7100

Media Relations: +1.408.944.7039

cadence®

Cadence Design Systems, Inc.

Corporate Headquarters: 2655 Seely Avenue, San Jose, CA 95134

P: +1.800.746.6223 (within US) +1.408.943.1234 (outside US)

www.cadence.com

© 2023 Cadence Design Systems, Inc. All rights reserved worldwide. Cadence, the Cadence logo, and the other Cadence marks found at www.cadence.com/go/trademarks are trademarks or registered trademarks of Cadence Design Systems, Inc. PCI Express and PCIe are registered trademarks of PCI-SIG. All other trademarks are the property of their respective owners.
J24859 12/23 SA/KZ/PDF

